

exceet Gesellschaft AEMtec in die Führung der europäischen SEMI Interessengruppe SIPAT berufen

- Vice Chair und Member of Executive Committee Position ermöglicht verstärkte Vernetzung und Einflussnahme bei internationalen Semiconductor back end Projekten
- Kunden profitieren von Informationen zu Fortschritten in der back end Halbleitertechnik aus erster Hand
- AEMtec bringt langjährige fachliche Expertise und Innovationskraft zur Stärkung der europäischen SIPAT Gruppe ein

Rotkreuz, Berlin 20. Juli 2016 – Die AEMtec GmbH, ein Unternehmen der internationalen Technologiegruppe exceet, wurde in den Führungskreis der Interessengruppe SIPAT (Semiconductor integrated Packaging and Test) berufen und übt ab sofort eine Vice Chair und Member of Executive Committee Position innerhalb der europäischen Vereinigung aus. Kunden der AEMtec profitieren somit von Informationen zu internationalen back end Projekten aus erster Hand. Darüber hinaus bietet ihnen AEMtec aufgrund der neuen Position innerhalb der SIPAT die Möglichkeit, eigene kundenspezifische Anforderungen schnell und zielgerichtet an IC Hersteller und Semiconductor Maschinenproduzenten heranzutragen.

AEMtec verfügt über umfangreiches Branchen- und Markt- Know-How und arbeitet seit Jahren aktiv in verschiedenen, führenden Fachverbänden der Elektronikbranche, wie ZVEI, IVAM und OPTEC. Darüber hinaus ist das Unternehmen, mit eigener Fertigungsstätte in Berlin, an zahlreichen Forschungsprojekten in der Halbleitertechnik beteiligt und verfügt über umfangreiche fachliche Expertise, speziell bei zukunftsweisenden Technologien und Produktionsverfahren.

Die SIPAT Gruppe vertritt die Interessen der europäischen Semiconductor Bestückungs- und Testing Anbieter innerhalb der weltweit agierenden SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) Organisation. Sie vernetzt in regelmäßigen Abständen IC Hersteller, Semiconductor Maschinenhersteller und eng damit verbundene Lieferanten. Aufgrund der neuen Rolle im Führungskreis der SIPAT stehen AEMtec aktuelle Informationen zu Semiconductor packaging Technologien frühzeitig zur Verfügung. AEMtec kann somit unverzüglich auf neue Projekt-Initiativen und Entwicklungstrends reagieren und den eigenen Kunden Wettbewerbsvorteile bieten. Hierbei profitieren die Kunden auch vom Austausch und der Anbahnung von Kooperationen innerhalb des europäischen Kultur- und Wirtschaftskreises, was in vielen Fällen kurze Entwicklungs- und Produktionszyklen begünstigt.

AEMtec mit Sitz in Berlin zählt seit Jahren zu den führenden Anbietern von innovativen mikro- und opto-elektronischen Komponenten und Module für Medizintechnik, Avionik, Industrie, Daten- und Telekommunikation sowie Automotive. Die exceet Gesellschaft verfügt über

herausragende Fertigungsmöglichkeiten und zählt namhafte, internationale Unternehmen zu seinen Kunden.

„Wir freuen uns innerhalb einer der in Europa und weltweit einflussreichsten Organisationen im Semiconductor-Markt eine so wichtige Rolle mit hohen Gestaltungsmöglichkeiten und dem direkten Zugriff auf wertvolle Marktinformationen einnehmen zu können“, so Dan Negrea, Geschäftsführer der AEMtec. „Dieses Asset gibt uns die Möglichkeit unsere Kunden zukünftig noch besser zu aktuellen Entwicklungen zu informieren und dieses Know-How in ihre Projekte einfließen zu lassen“.

Weitere Informationen zur SEMI Interessengruppe SIPAT finden Sie unter: <http://www.semi.org/en/semi-integrated-packaging-assembly-and-testing-sipat-special-interest-group#purpose>

Ihr AEMtec Direktkontakt im SIPAT Verband:

Hervé Delabre – Email: herve.delabre@aemtec.com - Tel. +33 6 03 37 56 40

Bildmaterial auf Anfrage verfügbar

Über exceet Group

exceet ist eine internationale Technologiegruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter, komplexer und sicherer Elektronik spezialisiert hat.

Über AEMtec GmbH

AEMtec, mit Firmensitz und Fertigungsstätte am renommierten Wissenschafts- und Technologiestandort Berlin Adlershof, bietet modernste Technologien für kundenspezifische komplexe (opto-) elektronische Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an High-end Chip-level-Technologien, wie Wafer Back-End Prozesse, Chip on Board, Flip Chip, 3D-Integration und Opto-Packaging. Umfangreiche Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Machbarkeitsstudien zur Aufbau- und Verbindungstechnik, Design und Layout sowie Testequipment-Erstellung bis hin zur Serienproduktion runden das Dienstleistungsspektrum ab.

Kontakt

exceet Group AG
Riedstrasse 1
CH-6343 Rotkreuz
Judith Balfanz, Editorial Director
Tel. +49 211 – 43 69 890
judith.balfanz@exceet.ch / www.exceet.ch